

選別に選ばれた森林からの原料を含むFSC®認証紙之環境に配慮した植物油インキを使用
しています。



お問合せ先
OBARA GROUP株式会社
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間3-2-10
TEL. 046-271-2122

www.obara-g.com

OBARA-G REPORT

第58期 第2 四半期報告書

2015年10月1日 …… 2016年3月31日

証券コード 6877

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。OBARA GROUPの2016年第2四半期連結累計期間における事業の概況等をご報告致します。

世界経済は、米国において景気回復の動きが持続したものの、アジア地域を始めとする新興国の経済成長の鈍化や欧州地域の不透明な景況感の継続などから、全体として低成長で推移しました。

我が国経済につきましては、個人消費に足踏みが見られるものの、設備投資は持ち直しの動きを示すなど、緩やかな景気回復が続きました。

そのような外部環境の中、溶接機器関連事業が、自動車メーカーの堅調な生産活動や設備投資による需要拡大への対応を継続的に展開する一方、平面研磨装置関連事業が、エレクトロニクス関連素材における新興国経済の成長鈍化を背景とした市況調整の影響を受けたことなどにより、当社の業績は、前年同期を下回る結果となりました。

なお、当社は株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要政策として認識しており、2016年1月から4月までに301千株(自己株式を除く発行済株式総数の1.62%)の自己株式を取得するとともに、2016年度の第2四半期末配当金につきましては、1株につき30円とし、本年6月10日を支払開始日とさせていただきます。



今後も不透明な経済環境が予想されますが、当社と致しましては、引き続き成長市場への経営資源の投入を積極的に推進し、顧客ニーズを満たす製品及びサービスの提供を行うことにより、業績向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、OBARA GROUPへの倍旧のご支援を心よりお願い申し上げます。

2016年6月

取締役社長 小原 康嗣

目次	株主の皆様へ ▶01	セグメント別事業概況 ▶05	主要経営指標の推移 ▶11	会社情報 ▶16	株主メモ ▶18
	営業の概況 ▶03	トピックス ▶09	連結財務データ ▶13	株式情報 ▶17	

営業の概況

連結業績サマリー

(百万円)

	第2四半期累計期間			通期		
	前期	当期	前年同期比	前期	当期(予想)	前期比
売上高	27,755	27,720	△0.1%	53,161	51,000	△4.1%
営業利益	5,969	6,073	1.7%	10,868	9,300	△14.4%
経常利益	6,227	6,066	△2.6%	11,410	9,650	△15.4%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	3,695	3,719	0.6%	7,593	5,670	△25.3%
1株当たり配当金	30円	30円	—	100円(年間)	60円(年間)	△40円

(注) 前期の期末配当金(確定)／1株当たり配当金70円(内訳 普通配当60円 記念配当10円)
 当期の期末配当金(予想)／1株当たり配当金30円(内訳 普通配当30円)

03

第2四半期連結累計期間の概況について

当社グループと深く関わる自動車業界につきましては、中国を中心としたアジア地域と米州地域などで、新モデル投入などによる設備投資が行われるとともに、生産活動についても堅調な動きが見られました。一方、同じく当社グループと深く関わるエレクトロニクス業界では、新興国経済の成長鈍化などを背景として設備投資及び生産活動に市況調整が見られました。

当社グループは、このような経営環境において各市場動向に応じた拡販に努め、ローカルニーズに対応した製品投入を進めたものの、第2四半期連結累計期間の業績は、前年同期を下回る結果となりました。

通期の見通しについて

自動車業界では、世界各地域において、高水準な設備投資や生産動向の継続が見込まれております。一方、エレクトロニクス業界では、スマートフォンなど主要エレクトロニクス製品の軟調傾向を受け、当面の調整局面が予想されております。そのような環境下、当社グループの通期業績につきましては、期初計画の水準を予想しておりますが、当社グループとしましては、成長市場での販売促進を鋭意図るとともに、積極的な設備投資と研究開発を行ってまいります。

なお、当連結業績予想は、1米ドル=112円の為替レートを前提としています。

04

セグメント別事業概況

溶接機器
関連事業

事業紹介

溶接機器関連事業とは

自動車業界を主要マーケットとする高効率な抵抗溶接機器を製造・販売しています。

自動車が出来るまで

●溶接機器関連事業と関わる自動車の製造プロセス

車体溶接

塗装

ぎ装

完成

出荷



車体溶接の設備

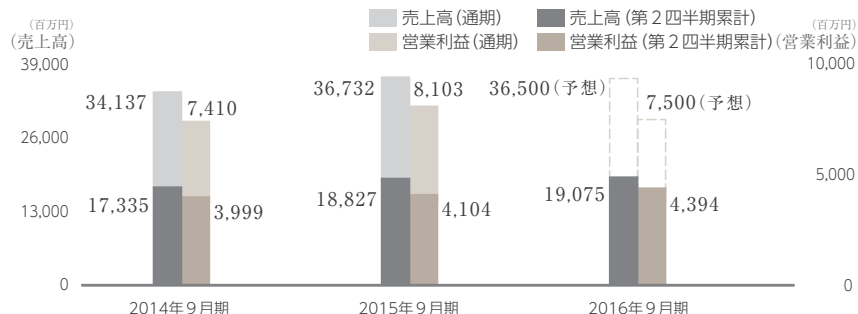
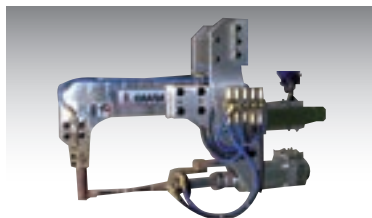
OBARA GROUP が提供する溶接機器

自動車ボディは薄板鋼板で構成されるため、抵抗溶接という接合工法が採用されています。

抵抗溶接は、接合ポイントに適切な加圧力と溶接電流を与える必要があります。自動車ボディの組立てには、各自動車モデル固有の立体形状に合わせ、個々の接合ポイントにカスタマイズされた溶接機器が設計・製造されます。

私たちは、国内外の自動車メーカーが行う設備増強やモデルチェンジに伴う設備更新に対し、半世紀に亘って培った経験と最先端の設計・生産技術により、最適な抵抗溶接設備を提案します。日々の生産活動に不可欠な消耗品と合わせ、自動車業界のパフォーマンス要望に応えます。

溶接機器関連事業



(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

溶接機器関連事業につきましては、取引先である日系・欧米系・アジア系自動車メーカーにおいて、中国を中心としたアジア地域や米州地域などで堅調な設備投資が行われ、世界各地域の自動車生産は概ね高水準となりました。このような環境の下、当事業として設備品及び消耗品の拡販を図ったことなどにより、業績は好調に推移しました。

この結果、当事業の売上高は190億75百万円(前年同期比1.3%増)、同営業利益は43億94百万円(前年同期比7.1%増)となりました。

売上高構成比



セグメント別事業概況

平面研磨
装置
関連事業

事業紹介

平面研磨装置関連事業とは

エレクトロニクス業界を主要マーケットとする精密研磨装置を製造・販売しています。

エレクトロニクス製品が出来るまで

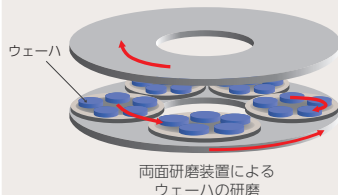
●平面研磨装置関連事業と関わるエレクトロニクス製品の製造プロセス

ウェーハ製造工程
インゴット引き上げ、切断、
ウェーハ研磨

半導体デバイス前工程
成膜、リソグラフィ、
エッチング等

半導体デバイス後工程
ダイシング、ボンディング、
モールドイング等

エレクトロニクス製品組込
完成した半導体デバイス(チップ)の
エレクトロニクス製品への搭載

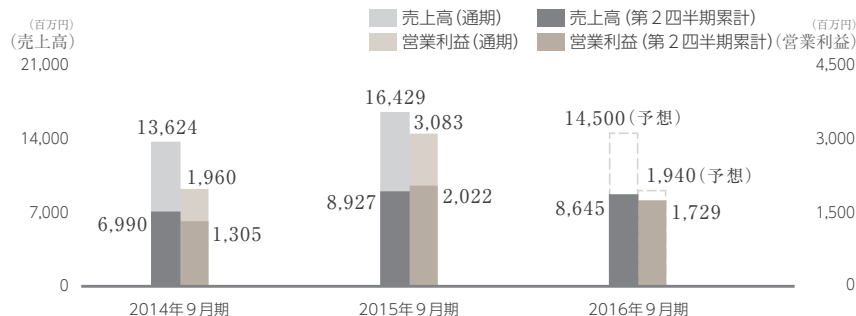


OBARA GROUP が提供する平面研磨装置

精密加工により製造される先端エレクトロニクス製品は、材料段階で高い面精度を基準平面として要求します。ロジックチップ・メモリーなどの半導体デバイスに用いられるシリコンウェーハ、通信・光デバイス基板、ハードディスク基板など、多様なエレクトロニクス素材の面精度の形成に、ダメージのない微細加工が可能な、遊離砥粒研磨装置が活躍しています。

現代社会を支える各種エレクトロニクス素材の期待水準に、私たちは、ナノオーダー対応の遊離砥粒研磨装置を中心とした精密装置ラインナップで応えます。また、信頼性の高い量産プロセスの確立に必要な、スラリー・研磨パッドなどの消耗副資材も開発・販売しています。

平面研磨装置関連事業



売上高構成比



平面研磨装置関連事業につきましては、スマートフォンなど主要エレクトロニクス製品の販売軟調などを受け、取引先であるエレクトロニクス関連素材においても、設備投資及び生産活動に調整の動きが見られました。このような環境の下、当事業として設備品及び消耗品の拡販を図ったものの、業績は前年同期を下回りました。

この結果、当事業の売上高は86億45百万円(前年同期比3.2%減)、同営業利益は17億29百万円(前年同期比14.5%減)となりました。

トピックス

溶接機器関連事業

国際ウエルディングショーに出展

2016年4月、当社グループは、インテックス大阪で開催された溶接・接合技術の総合展示会「国際ウエルディングショー」にて、生産設備の高効率化に寄与する自動車ボディ向け最軽量溶接ガンや高速溶接ガンの実機デモンストレーションを実施するとともに、お客様のご要望に応える各種消耗品を紹介しました。当社グループは、ユーザーそれぞれのニーズに細やかに対応した溶接システムなど、高付加価値製品の開発に引き続き注力してまいります。



国際ウエルディングショー

09

平面研磨装置関連事業

SEMICON JAPANに出展

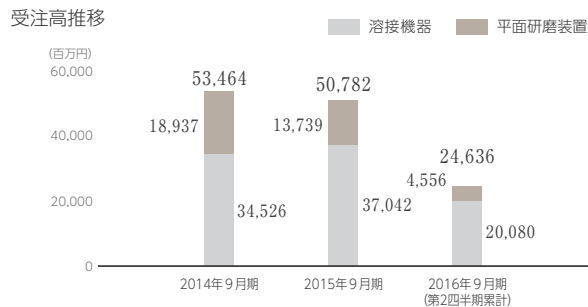
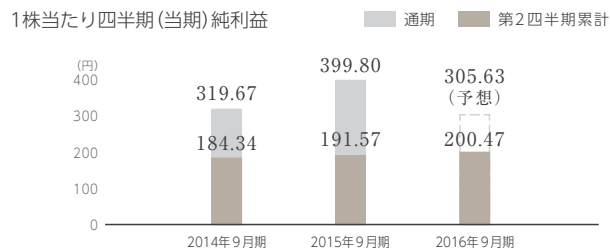
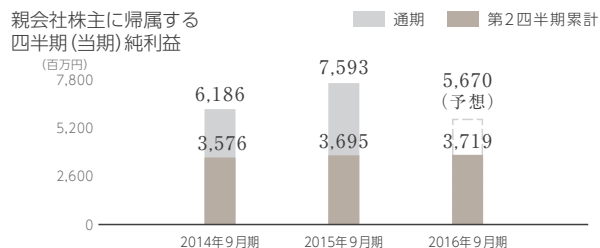
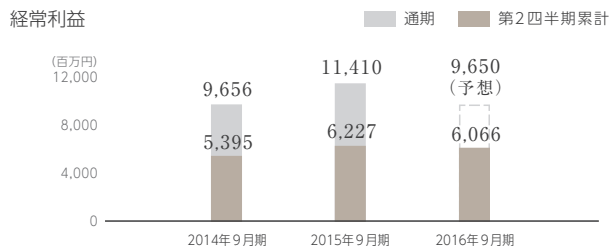
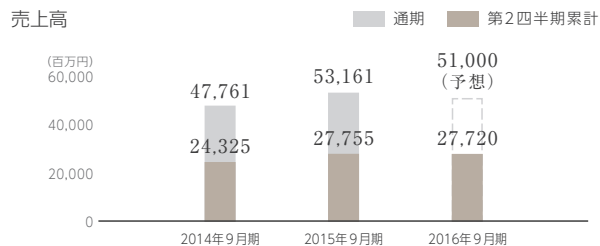
スマートフォンなどのエレクトロニクス製品には、最先端の半導体デバイスが搭載され、そのデバイスが形成されるシリコンウェーハの高精度化が進んでいます。2015年12月、半導体製造技術の展示会「SEMICON JAPAN」が東京ビッグサイトにて開催され、当社グループは、高精度ウェーハに対応した研磨装置・消耗副資材の総合ソリューションを提案したほか、SiC、GaNなどの新素材や、通信関連基板に対応した最新の装置ラインナップについても紹介しました。



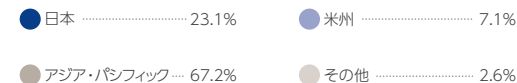
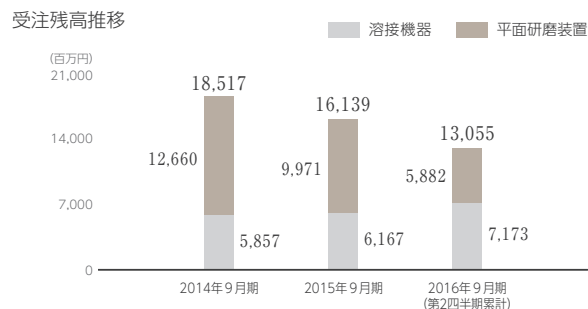
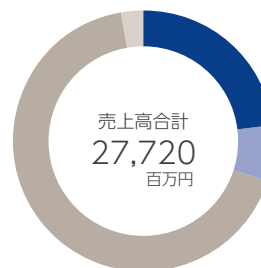
SEMICON JAPAN

10

主要経営指標の推移



地域別売上高構成比

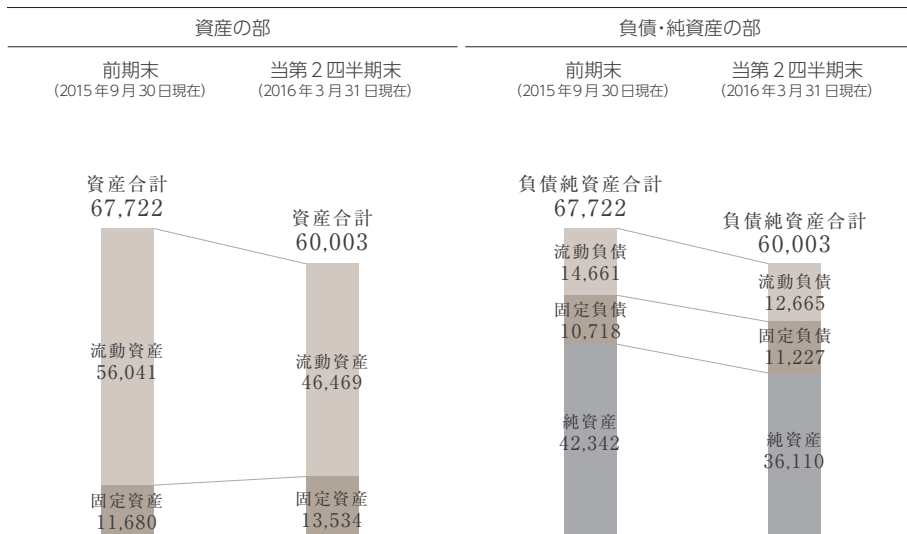


(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

連結財務データ

資産・負債・純資産の状況

(単位：百万円)



資産・負債

point
1

総資産は600億3百万円と、前期末と比べて77億19百万円減少しました。その他有形固定資産が12億65百万円増加した一方、有価証券が81億81百万円減少したことなどによります。負債は238億93百万円と、前期末と比べて14億87百万円減少しました。短期借入金が9億33百万円増加した一方、前受金が31億82百万円減少したことなどによります。

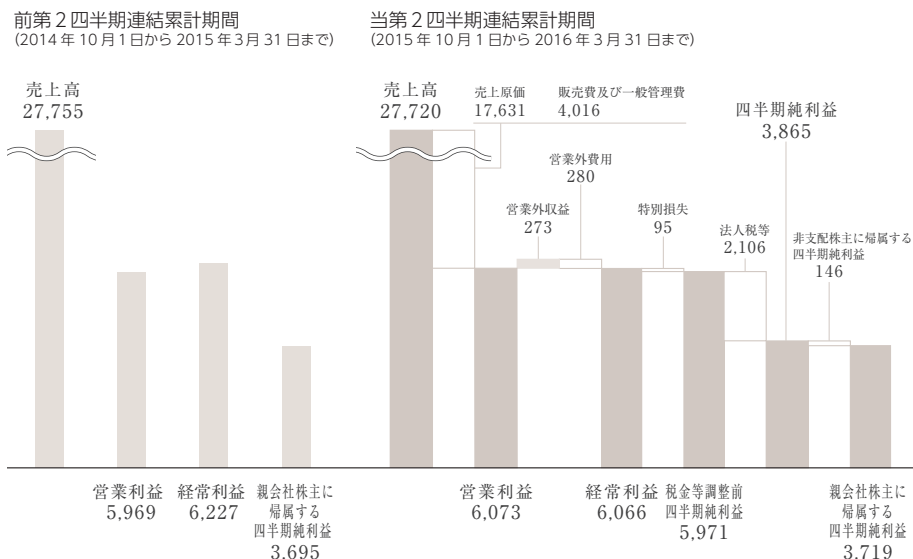
point
2

純資産

純資産は361億10百万円と、前期末と比べて62億32百万円減少しました。利益剰余金が17億25百万円増加した一方、子会社株式追加取得により資本準備金及び非支配株主持分がそれぞれ23億73百万円及び26億33百万円、円高により為替換算調整勘定が20億39百万円減少したことなどによります。

損益の状況

(単位：百万円)



point
3

売上高・営業利益・ 経常利益・親会社株主に 帰属する四半期純利益

連結売上高277億20百万円(前年同期比0.1%減)、営業利益60億73百万円(前年同期比1.7%増)、経常利益60億66百万円(前年同期比2.6%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は37億19百万円(前年同期比0.6%増)となりました。

point
4

営業外収支

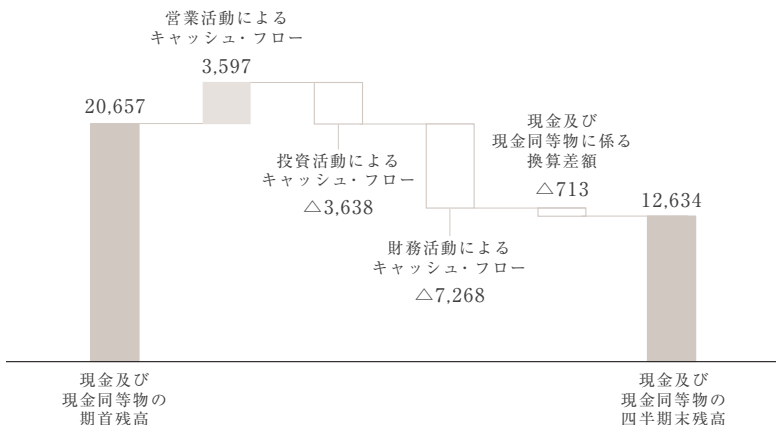
受取利息1億66百万円など、営業外収益が2億73百万円となった一方、為替差損2億3百万円など、営業外費用が2億80百万円となりました。

連結財務データ

キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間
(2015年10月1日から2016年3月31日まで)

(単位：百万円)



point
5

営業活動による キャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は、35億97百万円となりました。税金等調整前四半期純利益が59億71百万円、たな卸資産の減少額が22億86百万円となった一方、前受金の減少額が30億17百万円、法人税等の支払額が11億75百万円発生したことなどによります。

point
6

投資活動による キャッシュ・フロー

投資活動により支出した資金は36億38百万円となりました。定期預金の純増加額が8億43百万円、有形固定資産の取得による支出が15億57百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が11億48百万円発生したことなどによります。

point
7

財務活動による キャッシュ・フロー

財務活動により支出した資金は72億68百万円となりました。短期借入金の純増加額が8億23百万円となった一方、自己株式の取得による支出が8億72百万円、配当金の支払額が13億1百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出が59億6百万円発生したことなどによります。

15

会社情報 (2016年3月31日現在)

会社概要

商号	OBARA GROUP 株式会社
設立	1958年12月
資本金	19億25百万円
従業員数	20名(連結 1,654名)
本社所在地	神奈川県大和市中央林間3-2-10 046-271-1111(代表)
主な事業	持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、その他経営管理
ウェブサイト	http://www.obara-g.com/

役員

取締役社長	小原 康 嗣
取締役	小林 憲 史
取締役	周 澤 健
取締役	山下 光 久
社外取締役	大西 倫 雄*
常勤監査役	谷 内 博
社外監査役	須 山 正 志*
社外監査役	牧 野 宏 司*

* 証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。

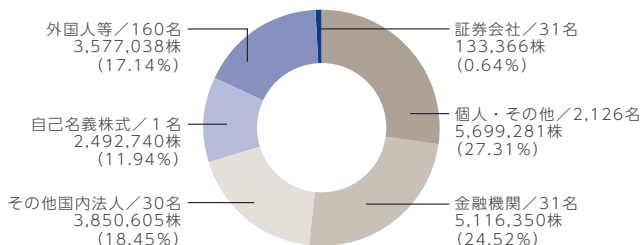
16

株式情報 (2016年3月31日現在)

株式状況

発行可能株式総数	38,000,000株
発行済株式総数	20,869,380株
単元株式数	100株
株主数	2,379名

株主分布状況



大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
有限会社馬込興産	3,703	20.15
小原 康嗣	2,571	13.99
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口9)	1,379	7.50
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	1,080	5.88
JP MORGAN CHASE BANK 385632	758	4.12
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	425	2.31
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578	413	2.24
株式会社三菱東京UFJ銀行	369	2.01
小原 範子	304	1.65
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY	279	1.52

- (注) 1. 上記のほか、自己株式2,492千株を保有しております。
 2. 持株比率は、自己株式2,492千株を控除して計算しております。
 3. 小原康嗣の持株数は自身の管理分株数1,084千株を加えて表示しております。

17

株主メモ

事業年度 毎年10月1日から翌年9月30日まで
 定時株主総会 毎年12月
 基準日 定時株主総会の議決権 毎年9月30日
 期末配当 毎年9月30日
 第2四半期末配当 毎年3月31日
 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。

株主名簿管理人 〒100-8233
 東京都千代田区丸の内1-4-1
 三井住友信託銀行株式会社

特別口座の
 口座管理機関 東京都千代田区丸の内1-4-1
 三井住友信託銀行株式会社

同事務取扱所 〒168-0063
 東京都杉並区和泉2-8-4
 三井住友信託銀行株式会社
 証券代行部
 TEL: 0120-782-031(フリーダイヤル)

同取次窓口 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

公告方法 当公司公告につきましては、下記ウェブサイトに掲載いたします。
<http://www.obara-g.com/>
 但し、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告を行なうことができない場合は、日本経済新聞に公告を掲載いたします。

18